LAGENAUFBAU HDI (Standard)

HDI12_1+10+1_1,70_35

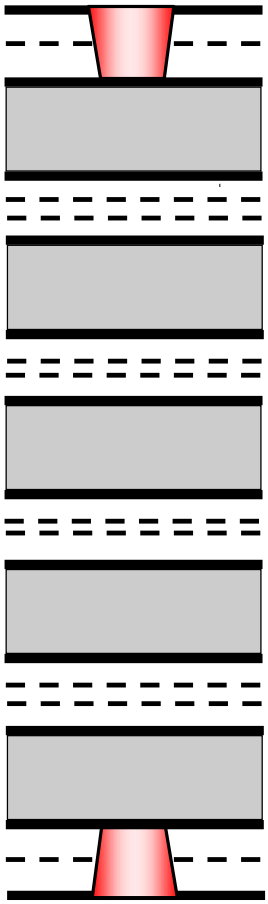
12 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.: | **1 + 10 + 1**

KUNDE:

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	60	
2	2			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
3	3			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
4	4			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
5	5			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
6	6			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
7	7			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
8	8			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
9	9			35 µm		33	
					2 x 1080	124	
10	10			35 µm		33	
			0,150 mm			150	
11	11			35 µm		33	
					1 x 1080	60	
12	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material: 1720

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,70**	+/-	0,15	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,79	+/-	0,18	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,85	+/-	0,20	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision		
28.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	Seite:	1+